

# 深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 234,314,304 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	同兴达	股票代码	002845
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李岑	宫兰芳	
办公地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-72 号银星智界 2 号楼 1301-1601	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-72 号银星智界 2 号楼 1301-1601	
传真	0755-33687791	0755-33687791	
电话	0755-33687792	0755-33687792	
电子信箱	zqswdb@txdkj.com	zqswdb@txdkj.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要从事LCD、OLED显示模组、光学摄像头模组及半导体先进封测的研发、设计、生产和销售，其中显示模组主要产品包括智能手机类、平板及笔记本电脑类、智能穿戴类及专业显示类；光学摄像头模组主要产品包括手机摄像头、平板及笔记本电脑摄像头、智能产品类（智能手表、视讯通话等）摄像头、感知类（扫地机器人等）摄像头、识别类（智

能门锁、人脸识别等)摄像头,上述产品主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、NOTEBOOK、车载、无人机、智能家居等领域。

**液晶显示模组主要应用场景如下:**



智能手机

笔记本电脑

平板电脑

智能穿戴

专业显示

**光学摄像头模组主要应用场景如下:**



智能手机


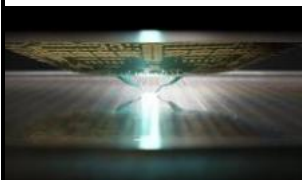
无人机

生物识别

子公司赣州同兴达作为公司液晶显示模组业务的载体,自2017年起不断投入优质资源,着力打造高端制造平台,现拥有智能手机类、智能穿戴类和平板电脑/笔记本电脑等一体化生产线40余条,已成为行业标杆智慧化工厂;

子公司南昌精密作为公司光学摄像头模组业务的载体,自2017年9月投产以来,凭借内部精细化管理及精益求精的质量要求,得到了下游优质大客户的认可,主流产品由目前8M至104M的手机类高像素产品逐步扩充到笔记本电脑、平板至工控、智能家居等更多领域。

子公司昆山同兴达设立于2021年12月,主要从事半导体先进封测业务,拟投建全流程金凸块制造(GoldBumping)+晶圆测试(CP)+玻璃覆晶封装(COG)及薄膜覆晶封装(COF)(一期)等完整封测制程,同时考虑GoldBump(金凸块)制程兼容铜镍金凸块、厚铜、铜柱凸块,建成月产能2万片12寸全流程GoldBump(金凸块)生产工厂,主要应用于显示驱动IC(含DDI和TDDI)及CIS(CMOS Image Sensor)封测领域,具体业务如下:

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域	完成相关制程后的产品图示
GoldBumping	金凸块制造是指通过溅镀、曝光显影、电镀和蚀刻等制程,在晶圆的焊垫上制作金凸块,可达到高密度、散热高效的电性传输,替代了传统封装中的导线键合。	该工艺可大幅缩小芯片模组的体积,具有密度大、散热佳、高可靠性等优点	主要应用于显示驱动芯片领域,适用于覆晶封装(FC)技术	
CP	晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性,对于检测不合格的晶粒用点墨进行标识,在切割环节被淘汰,不再进行下一个制程	该工艺不仅可以鉴别出合格的芯片,直接计算出良率,还可以减少后续不必要的操作,有效降低整体封装的成本	是大多数封装工艺必经的前道工序	

COG	玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板上的引脚进行接合并利用胶质材料进行密封隔绝的技术，由封装厂商负责切割成型，面板或模组厂商等负责芯片与面板的接合	是目前较为传统的屏幕封装工艺，也是最具性价比的解决方案，但由于芯片直接放置在玻璃基板上，占用较大空间，故屏占比不高	是目前主流的屏幕封装工艺，也是最具性价比的解决方案，但由于芯片直接放置在玻璃基板上，占用较大空间，故屏占比不高。	
COF	薄膜覆晶封装是指将芯片的金凸块与卷带上的内引脚接合，之后由面板或模组厂商等将外引脚与玻璃基板接合	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点，有利于缩小屏幕边框，提高屏占比	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点，有利于缩小屏幕边框，提高屏占比	

**(二) 公司所处行业的发展趋势:**

**1、液晶显示器正向轻、窄、薄，显示质量更高、显示界面更大、内容更丰富的方向发展**

随着面板技术的不断进步，手机屏幕除了显示材料的升级以外，高屏占比（全面屏）脱颖而出。全面屏从高像素和大视野两方面给予消费者更佳的视觉体验，现已成为智能手机市场的主流。主要手机厂商华为、苹果、三星、小米、vivo、OPPO 等都已在自己的主要产品中应用了全面屏，并向中低端机型不断渗透，市场前景广阔。

全面屏手机要求对显示面板进行精度极高的异形切割、打磨和贴片组装，同时全面屏又有不同的实现方案，包括刘海屏、水滴屏、挖孔屏、双屏、滑盖屏、机械升降等，不同的方案对设备工艺的要求又不尽相同，从而对显示模组厂商的制程能力、工艺水平提出了革命性的改变。

**2、高端产品封装技术由COG向COF、COP发展**

随着全面屏手机的推广，手机屏占比不断上升，为追求窄边框和更高的屏占比，全面屏逐渐从18:9向19:9甚至20:9演进，为了追求更小的下Border从而要求液晶显示触控模组生产企业的封装技术需由传统的COG向COF、COP发展。传统的COG封装技术系将触控IC固定在玻璃上，而COF、COP技术则将触控IC固定于软板上，由于可以自由弯曲，因此可以将其折到玻璃背面，从而实现缩小下边框的目的。

**3、智能手机摄像头高像素趋势明显，车载摄像头市场快速崛起**

像素越高，拍摄的图像分辨率越高，描述的细节越丰富，图像被放大后较低像素者更为清晰。从低像素提升至高像素对图像清晰度能有明显改善，因此一般消费者关注手机拍摄参数时通常最先关注像素，手机厂商亦会优先考虑提高像素，智能手机摄像头高像素趋势明显；

同时，随着市场及政策环境的日趋成熟，汽车智能化浪潮汹涌而来。作为汽车智能化中不可或缺的核心感知硬件，车载摄像头的应用从传统的倒车后视向全场景、多方位拓展，由单摄向多摄迈进，从成像镜头向感知镜头转变，前景广阔，行业迎来加速向上拐点。

**4、随着显示技术的不断拓展，显示驱动芯片封测向高度集成化发展**

近年来，国家大力推进超高清视频产业及相关领域的发展和應用，4K和8K电视对高动态范围、高色域、高对比度、高光效、高分辨率等方面提出了新的要求，因此发展出了AMOLED、MiniLED、MicroLED等新型显示技术。面对新型显示技术，显示驱动芯片要突破尺寸缩小、电流显示均匀性好、芯片输出电流通道间相互串扰小、可靠性高等一系列难题，因此显示驱动

芯片的封测需要集成更多数量晶体管以提升芯片性能，而且还需要将多个功能模块封装在同一个芯片里从而实现多功能集成，整体显示驱动芯片的封测向高度集成化发展。

### 5、柔性OLED未来前景广阔

消费电子产品正朝着柔性化、便携化的方向持续升级，超高清、低功耗、轻薄化、更具柔性的显示形态、功能的高度集成化等市场需求加快显示技术迭代更新。与传统的LCD屏幕相比，柔性OLED屏幕具有低能耗、更轻薄、响应快、可弯曲等特点。随着柔性显示的发展，除我们已经看到的曲面屏手机、柔性折叠手机、柔性折叠笔记本电脑，车载显示等领域外，柔性折叠触控模组还将广泛应用于个人数字助理设备、医疗、金融等众多行业的电子设备中，柔性OLED屏幕已成为显示行业的发展热点。柔性OLED产品将会在未来得到迅猛的发展，前景极为广阔。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	9,279,166,386.75	9,326,361,005.94	-0.51%	6,400,650,879.29
归属于上市公司股东的净资产	2,765,895,146.75	2,371,945,390.35	16.61%	1,258,668,135.88
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	12,860,424,157.98	10,601,084,867.69	21.31%	6,195,959,819.12
归属于上市公司股东的净利润	362,055,571.72	257,993,850.37	40.33%	110,553,727.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,886,298.14	206,693,285.43	38.31%	2,050,835.30
经营活动产生的现金流量净额	936,702,371.48	76,953,356.06	1,117.23%	393,895,669.41
基本每股收益（元/股）	1.55	1.240	25.00%	0.550
稀释每股收益（元/股）	1.55	1.240	25.00%	0.550
加权平均净资产收益率	14.24%	17.00%	-2.76%	9.19%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,670,610,681.28	3,474,357,220.66	2,871,274,477.02	3,844,181,779.02
归属于上市公司股东的净利润	100,942,286.58	144,358,060.66	81,335,534.77	35,419,689.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,729,087.17	134,587,335.69	61,488,607.69	18,081,267.59
经营活动产生的现金流量净额	220,504,448.53	320,370,351.11	-120,960,874.47	516,788,446.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,212	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
万锋	境内自然人	22.67%	53,114,337	39,835,753	质押	20,790,000	
钟小平	境内自然人	18.57%	43,522,000	32,641,500	质押	14,450,000	
李锋	境内自然人	3.87%	9,072,000	0			
刘秋香	境内自然人	3.40%	7,962,000	0			
共青城泰欣德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	5,725,800	0			
李爱国	境内自然人	1.46%	3,426,900	0			
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.23%	2,871,813	0			
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.22%	2,849,670	0			
施玉庆	境内自然人	1.06%	2,492,700	0			
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.00%	2,351,150	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东万锋和李锋为夫妻关系，股东钟小平和刘秋香为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						

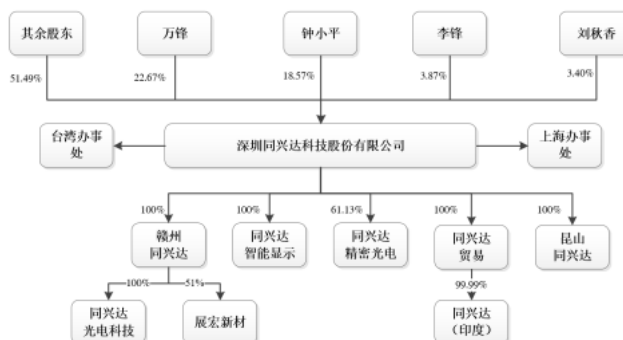
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

2021年10月15日，公司发布了与昆山日月新（原昆山日月光）签订《项目合作框架协议》的公告，拟在昆山投资设立全资子公司，实施“芯片金凸块（GoldBump）全流程封装测试项目”项目（一期），强势涉足集成电路先进封测行业，主要应用于显示驱动芯片封测领域。

凸块制造（Bumping）是一种新型的芯片与基板间电气互联的方式，这种技术通过在晶圆上制作金属凸块实现。具体工艺流程为：晶圆在晶圆代工厂完成基体电路后，由封测代工厂在切割之前进行加工，利用薄膜、黄光、电镀、蚀刻等技术，在芯片的焊垫上制作金属焊球或凸块。相比传统的打线技术向四周辐射的金属“线连接”，凸块制造技术反映了以“以点代线”的发展趋势，可以大幅缩小芯片体积，具有密度大、低感应、低成本、散热能力优良等优点；且凸块阵列在芯片表面，引脚密度可以被做得极高，便于满足芯片性能提升的需求。

2021年9月7日公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定及公司2021年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件已经成就，同意将本次激励计划授予日确定为2021年9月7日，按13.07元/股的授予价格向符合条件的14名激励对象授予697,600股限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。